

注：此文档来源于网络，仅供同行分享学习使用，如有侵权，请联系删除！联系方式：coolens@coolens.cn

芯片外观视觉检测

芯片外观视觉检测

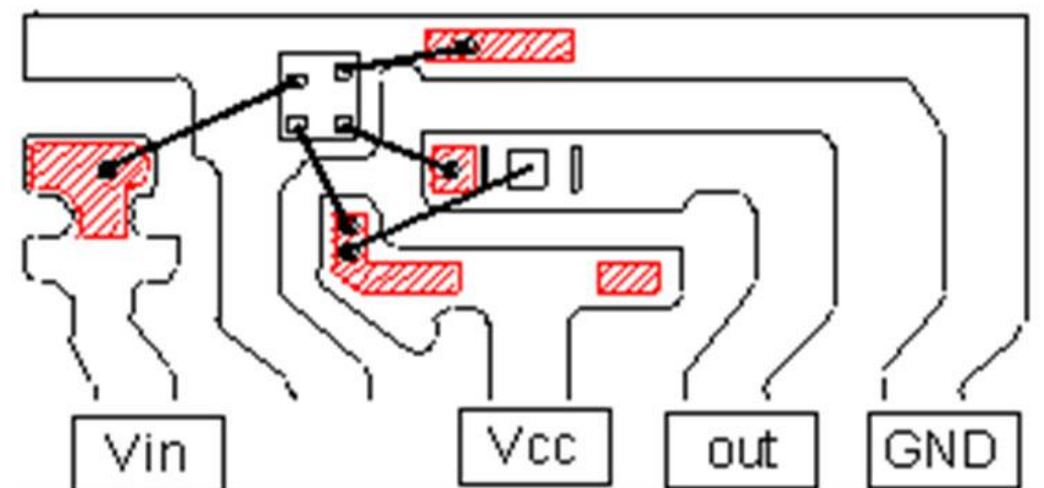
选用的是 1 个 500 万彩色相机 (像素组成 2592*1944) 在 4mm 的视野范围内进行检测以下评估内容 1 和 2。

在该状态下的 500 万检测分辨率为： $4\text{mm} / 2592 \text{ 像素} = 0.0015\text{mm}/\text{像素}$

检测项目

1. 焊点位置错误，

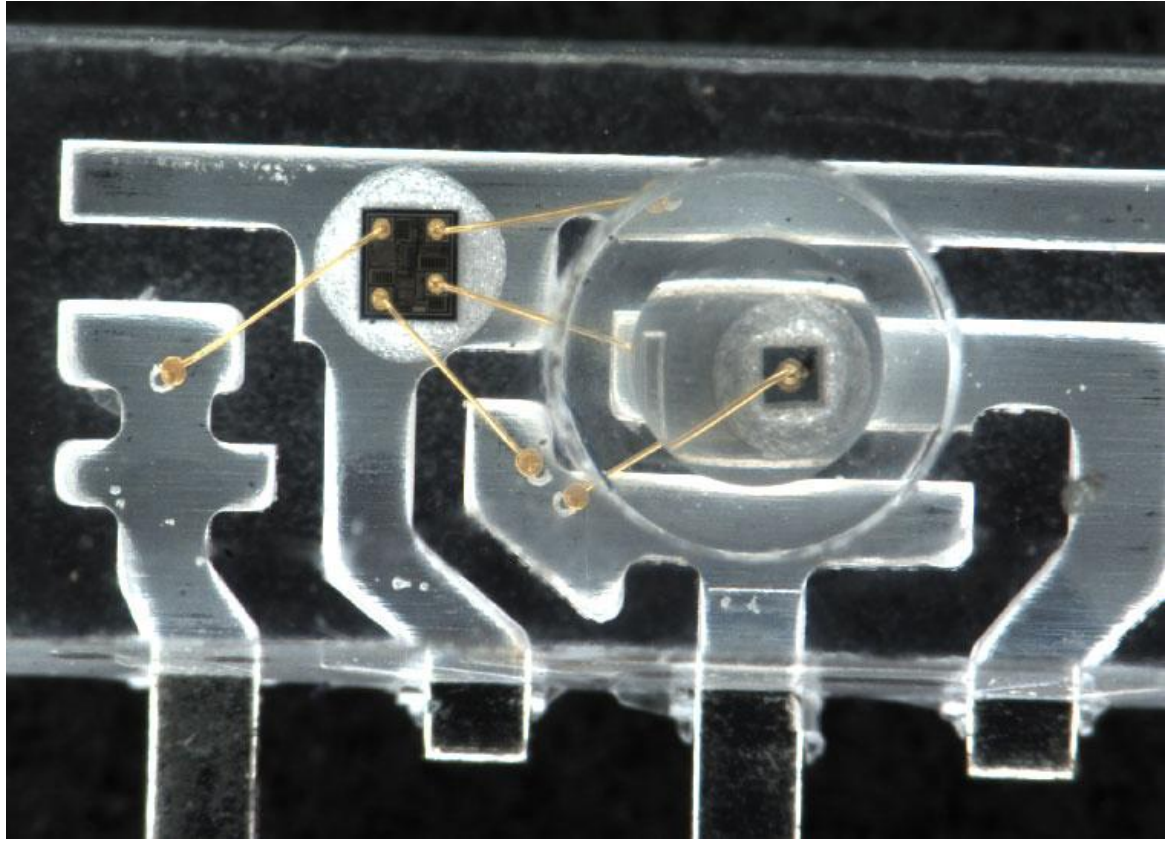
检测第二焊点焊线的公差位置如下图，当焊点全部超出红色线色范围外就判定 NG。



2. 铜线有无检测，

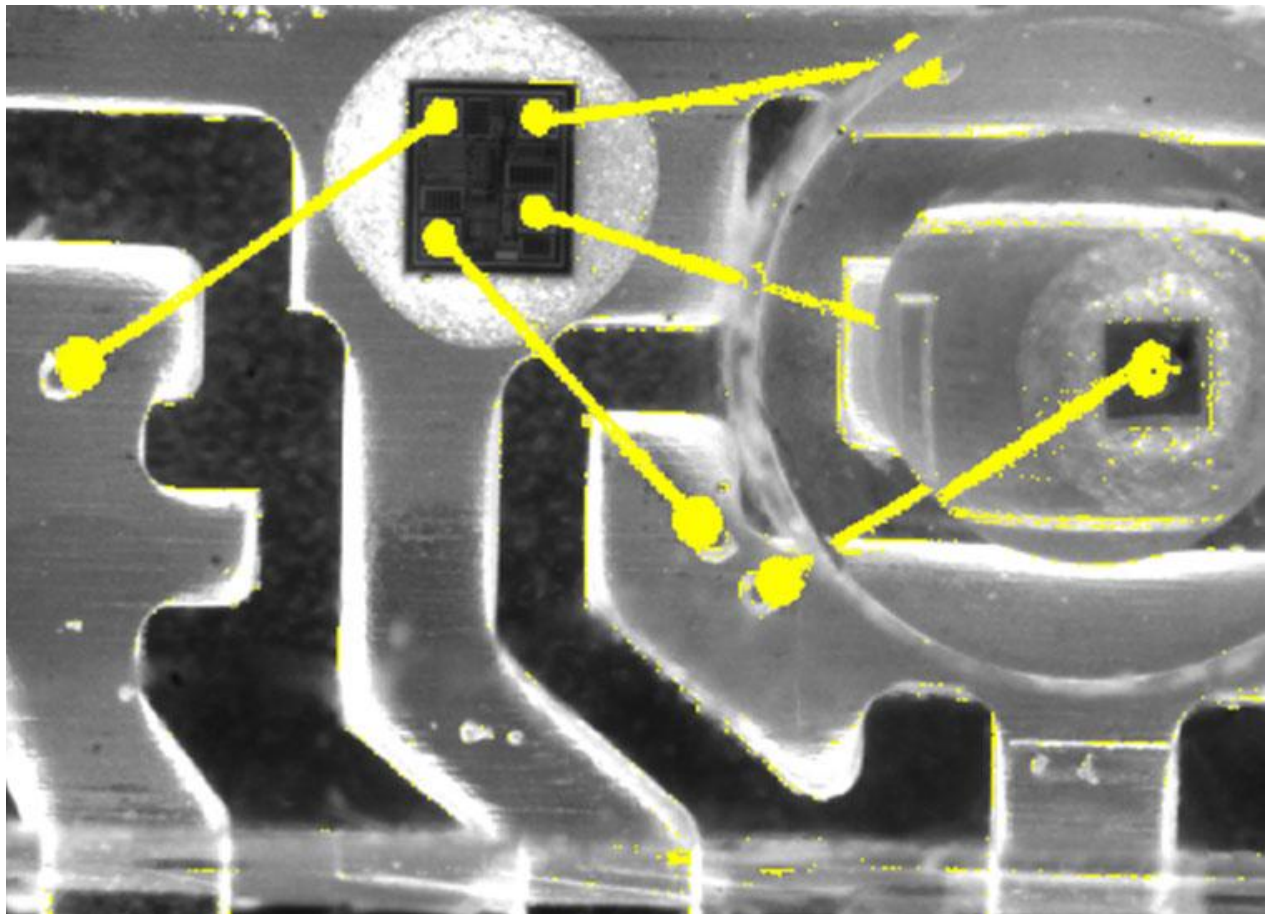
检测铜线有无，当没有铜线时判定 NG。

产品拍摄图



处理图

利用颜色抽取功能来抽取判定我们要检测的对象的视觉效果图



用彩色二值化处理后效果图,要检测部分被二值化为白色,可以稳定检测铜线有无。

